

**第186回 TMC 技術研修会**

オープンセミナー「ものづくり現場のIoT/AI」のご案内

NPO 法人テクノメイトコープ (TMC)

TMC では、中小企業さま向け支援等 NPO 事業活動のため、月例技術研修会を実施しています。  
今回は、家電の街として発展してきた大阪の「ものづくり現場のIoT/AI」関連の最新トピックスを、TMC 技術研修会/オープンセミナーとして、以下開催致します。

TMC 会員各位、および広く関係の方々の、積極的なご参加をお待ちしています。

開催日時：令和1年10月23日(水) 13時～(開場12時30分)

会 場：大阪市立大学 梅田サテライト 大講義室(101教室)

大阪駅前第2ビル6階(大阪市北区梅田 1-2-2-600)

◆13時～13時10分：主催者挨拶 大阪市立大学名誉教授 理事長 大嶋 寛

◆13時10分～14時30分(80分)

**「シャープ再建 鴻海流日本型リーダーシップと8K・AIoT 戦略」**

立命館アジア太平洋大学 名誉教授 中田 行彦 氏

関西を代表し、液晶の勝ち組であったシャープが、債務超過に落ち込み、台湾の鴻海の傘下となった。それから2年の時を経て、シャープは復活を遂げた。

なぜ鴻海の傘下でシャープは復活できたのか？ シャープと大学での経験を踏まえ、シャープ 戴社長との面談から生まれた 拙著「シャープ再建」を基に話をします。

★当日、中田先生の著書「シャープ再建」を会場にご持参いただいた方には  
中田先生がその本に、署名をご記入していただけます。

◆14時30分～15時20分(50分)

**「パナソニック AI 劣化診断サービスの技術説明」**

パナソニック株式会社 | S社 メカトロニクス事業部 技術開発センター

システム技術部 主幹技師 池田 和隆 氏

パナソニックはFAの現場経験と検査技術の集大成として、センサそのものを開発、人工知能技術を活用しロバスト設備劣化診断技術を開発しました。その内容をご紹介します。

◆15時30分～16時20分(50分)

**「RFID から LPWA まで。各種無線通信技術を利用したものづくり現場のIoT をご紹介」**

株式会社ワイズ・ラブ 代表取締役 内橋 義人 氏

IoTの原点である「RFID」。その利用ソリューションのパイオニアとして製造現場導入事例を紹介するとともに、最新無線技術LPWAや5Gの普及を見据えた 近未来のIoTを考えます。

◆16時20分～16時50分(30分)

**「大阪府 IoT 推進ラボ：AI・IoT 推進コンソーシアムとIoT 先進企業のご紹介」**

大阪府商工労働部 中小企業支援室 IoT 推進ラボ担当 総括主査 辻野 一郎 氏

大阪府では、中小企業診断士が企業を訪問しIoT導入方策を提案する「IoT診断」やIoTシステムインテグレータを紹介する「IoTマッチング」などに加え、今般、「大阪府AI・IoT推進コンソーシアム」を立ち上げ、ものづくり企業とIT事業者のネットワーク化をめざしています。

◆終了後 名刺交換会予定

※参加費(資料代)：1000円。但し法人会員は無料、個人正会員は500円。(当日徴収します)

※ご出欠は、Eメール、Tel、Faxにて、10月16日までに、ご連絡願います。

<ご所属等、参加者のお名前、ご連絡先(Tel、E-Mail)、TMC会員区分>

E-Mail：[tmc-osk@crux.ocn.ne.jp](mailto:tmc-osk@crux.ocn.ne.jp) Tel：06-4963-9876 Fax：06-4963-9878